

同宇新材料（广东）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“同宇新材”、“发行人”或“公司”）所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 38.62 倍。本次发行价格 84.00 元/股对应发行人 2024 年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为 23.94 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 38.62 倍（截至 2025 年 6 月 26 日），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司 2024 年扣非前后孰低归母净利润对应的静态市盈率的算术平均数 27.78 倍（截至 2025 年 6 月 26 日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

同宇新材根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕，以下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号，以下简称“《首发业务实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。

2、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 **84.00 元/股**。

投资者请按此价格在 2025 年 7 月 1 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为 2025 年 7 月 1 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

4、网上投资者申购新股中签后，应根据 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）披露的《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司的相关规定。2025 年 7 月 3 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

5、中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，

自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读本公告及 2025 年 6 月 30 日（T-1 日）披露的《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

8、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大事项。

估值及投资风险提示

1、根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），同宇新材所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 38.62 倍。本次发行价格 84.00 元/股对应发行人 2024 年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为 23.94 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 38.62 倍（截至 2025 年 6 月 26 日），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司 2024 年扣非前后孰低归母净利润对应的静态市盈率的算术平均数 27.78 倍（截至 2025 年 6 月 26 日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

3、本次公开发行新股 1,000.00 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目计划所需资金额为 130,000.00 万元。按本次发行价格 84.00 元/股，发行人预计募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除预计发行费用 7,962.17 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 76,037.83 万元，低于前述募投项目计划所需资金总额，请投资者注意所筹资金不能满足使用需求的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、同宇新材首次公开发行不超过 1,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕907 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司。发行人股票简称为“同宇新材”，股票代码为“301630”，该简称和代码同时用于本次发行网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），同宇新材所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2、发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行新股数量为 1,000.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%。本次发行均为新股，全部为网上发行，原股东不公开发售股份。本次公开发行后总股本为 4,000.00 万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

3、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行价格为 84.00 元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）17.58 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）17.96 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）23.45 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

(4) 23.94 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率38.62倍及平均滚动市盈率36.03倍。（截至2025年6月26日（T-3日））。

4、据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》的通知，关于上市条件等事宜的适用衔接安排仍按照《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）〉的通知》和相关规定执行，已经通过深交所上市审核委员会审议的拟上市公司，适用原规则第 2.1.2 条规定的上市条件。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 2.1.2 条，发行人选择的具体上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。发行人 2023 年、2024 年归属于母公司股东的净利润分别为 16,447.93 万元和 14,330.56 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 15,957.83 万元和 14,033.39 万元，最近两年扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元，因此发行人符合上述上市标准。

5、网上发行重要事项

本次网上申购时间为 2025 年 7 月 1 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2025 年 7 月 1 日（T 日）前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在 2025 年 6 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2025 年 6 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值 1 万元以上（1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 10,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2025 年 7 月 3 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2025 年 6 月 27 日（T-2 日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）上的《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网以及巨潮资讯网上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、同宇新材、公司	指同宇新材料（广东）股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、兴业证券	指兴业证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
本次发行	指同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行 1,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行 1,000.00 万人民币普通股（A 股）之行为
投资者	指 2025 年 7 月 1 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限且在 2025 年 6 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）的规定。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
T 日	指本次网上定价发行申购股票的日期，即 2025 年 7 月 1 日
元	指人民币元

一、发行价格

（一）发行价格的确定

发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行价格为 84.00 元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）17.58 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）17.96 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）23.45 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）23.94 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

（二）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

1、与行业市盈率的比较情况

公司主营业务系电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括 MDI 改性环氧树脂、DOPO 改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA 型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。电子树脂、覆铜板和印制电路板，已然成为现代电子产品中不可或缺的重要组成部件，最终被广泛应用于智能家电、工业控制、计算机、消费电子、汽车电子、通讯等各个行业。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2025 年 6 月 26 日，中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）

最近一个月平均静态市盈率为 38.62 倍，中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均滚动市盈率为 36.03 倍。

（1）与行业平均静态市盈率比较

本次股票发行价格为 84.00 元/股，对应的发行人 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后静态市盈率为 23.94 倍，低于 2025 年 6 月 26 日中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 38.62 倍。

（2）与行业平均滚动市盈率比较

本次股票发行价格为 84.00 元/股，对应的发行人前四个季度（2024 年 4 月至 2025 年 3 月）扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后滚动市盈率为 24.00 倍，低于 2025 年 6 月 26 日中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率 36.03 倍。

（3）发行人所属行业变化态势

截至 2025 年 6 月 26 日，C39 行业各阶段平均静态市盈率和平均滚动市盈率如下：

行业名称	最近一个月平均静态市盈率	最近三个月平均静态市盈率	最近六个月平均静态市盈率	最近一年平均静态市盈率
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	38.62	38.64	40.55	37.91

数据来源：中证指数有限公司。

行业名称	最近一个月平均滚动市盈率	最近三个月平均滚动市盈率	最近六个月平均滚动市盈率	最近一年平均滚动市盈率
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	36.03	35.99	37.74	35.52

数据来源：中证指数有限公司。

2024 年以来，计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）行业平均市盈率水平较为平稳，本次发行价格 84.00 元/股对应发行人 2024 年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 23.94 倍，低于中证指数有限公司发布的计算机、

通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率 38.62 倍。本次发行价格 84.00 元/股对应发行人前四个季度（2024 年 4 月至 2025 年 3 月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为 24.00 倍，亦低于中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均滚动市盈率 36.03 倍，处于合理水平（截至 2025 年 6 月 26 日）。

2、与同行业可比上市公司的比较情况

(1) 同行业可比公司的选择情况

报告期内，国内 A 股并不存在与公司业务、产品完全一致的上市公司，因此按照业务及产品类别选取同行业可比公司。

东材科技主营业务中的电子材料主要应用于覆铜板领域，其电子材料中的含磷环氧树脂与发行人的 DOPO 改性环氧树脂具有可比性，其中 MDI 改性环氧树脂和双酚 A 酚醛环氧树脂与发行人的 MDI 改性环氧树脂和 BPA 型酚醛环氧树脂具有可比性；宏昌电子主营业务中的阻燃型环氧树脂主要应用于覆铜板领域，其阻燃环氧树脂中的无卤环氧树脂与发行人的 DOPO 改性环氧树脂具有可比性；圣泉集团主营业务中的先进电子材料及电池材料/电子化学品主要应用于覆铜板领域，其先进电子材料及电池材料/电子化学品中的 BPA 酚醛环氧树脂与发行人的 BPA 型酚醛环氧树脂具有可比性。上述业务均为发行人的可比业务，故选取东材科技、宏昌电子、圣泉集团作为可比公司。具体情况如下：

公司名称	产品名称	产品特点	产品用途	与发行人产品是否可比	选取理由
圣泉集团	BPA 酚醛环氧树脂	(1) 环氧氯丙烷与双酚 A 或多元醇的缩聚产物； (2) 具有优良的耐热性、耐化学品性、耐湿性，以及优良的绝缘性和粘结性	EMC 电子封装材料、覆铜板、电子油墨等	是，BPA 型酚醛环氧树脂	(1) 招股说明书披露的工艺流程与发行人产品类似； (2) 产品特点类似； (3) 产品用途包括覆铜板； (4) 主要客户部分重合
东材科技	含磷环氧树脂	无卤阻燃型环氧树脂，固化后具有优良的阻燃性、尺寸稳定性及化学稳定性	应用于覆铜板领域	是，DOPO 改性环氧树脂	(1) 产品特点（无卤、含磷阻燃）类似； (2) 产品用途相同；

公司名称	产品名称	产品特点	产品用途	与发行人产品是否可比	选取理由
					(3) 主要客户类似
	MDI 改性环氧树脂	提升材料体系对铜箔的粘结力，提升材料体系的柔韧性和耐热性		是，MDI 改性环氧树脂	(1) 产品特点类似； (2) 产品用途相同
	双酚 A 酚醛环氧树脂	(1) 环氧氯丙烷与双酚 A 或多元醇的缩聚产物； (2) 具有优良的耐热性、耐化学品性、耐湿性，以及优良的绝缘性和粘结性		是，BPA 型酚醛环氧树脂	
宏昌电子	阻燃型环氧树脂（无卤环氧树脂）	酚醛环氧树脂、双酚 A、阻燃剂触媒反应，送入到溶剂中溶解	应用于电子电气行业，主要用于覆铜板生产	是，DOPO 改性环氧树脂	(1) 产品特点与发行人产品类似； (2) 产品用途相同； (3) 主要客户部分重合

(2) 与同行业可比公司的市盈率比较

以 2025 年 6 月 26 日为例，可比公司的静态市盈率情况如下：

证券代码	证券简称	2025 年 6 月 26 日（含）前 20 个交易日均价及前一日收盘价孰低值（元/股）	2024 年扣非前 EPS（元/股）	2024 年扣非后 EPS（元/股）	对应的静态市盈率（倍）- 扣非前	对应的静态市盈率（倍）- 扣非后
601208.SH	东材科技	9.33	0.2019	0.1384	46.21	67.41
603002.SH	宏昌电子	6.01	0.0446	0.0375	134.75	160.27
605589.SH	圣泉集团	27.23	1.0253	0.9803	26.56	27.78
算术平均数（剔除异常值）					26.56	27.78
-	同宇新材	-	3.5826	3.5083	23.45	23.94

数据来源：Wind，数据截至 2025 年 6 月 26 日。

注 1：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额÷前 20 个交易日（含当日）成交总量；

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 3：同宇新材总股本按照发行后 4,000 万股计算，2024 年扣非前/后 EPS=2024 年归属于发行人股东的扣除非经常性损益前/后的净利润÷2025 年 6 月 26 日总股本；

注 4：宏昌电子市盈率显著高于其他可比公司，东材科技 2024 年业绩大幅下降，故以上可比公司作为极端值及异常值剔除。

以 2025 年 6 月 26 日为例，可比公司的滚动市盈率情况如下：

证券代码	证券简称	2025 年 6 月 26 日（含）前 20 个交易日均价及前一日收盘价孰低值（元/股）	扣非前 EPS-TTM（元/股）	扣非后 EPS-TTM（元/股）	对应的滚动市盈率（倍）- 扣非前	对应的滚动市盈率（倍）- 扣非后
601208.SH	东材科技	9.33	0.2478	0.1820	37.65	51.26
603002.SH	宏昌电子	6.01	0.0398	0.0340	151.01	176.76
605589.SH	圣泉集团	27.23	1.1073	1.0576	24.59	25.75
算术平均数（剔除异常值）					31.12	38.51
-	同宇新材	-	3.5442	3.5000	23.70	24.00

数据来源：Wind，数据截至 2025 年 6 月 26 日。

注 1：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额÷前 20 个交易日（含当日）成交总量；

注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注 3：同宇新材总股本按照发行后 4,000 万股计算，扣非前/后 EPS-TTM=2024 年 4 月至 2025 年 3 月归属于发行人股东的扣除非经常性损益前/后的净利润÷2025 年 6 月 26 日总股本；

注 4：宏昌电子作为异常值处理。

本次发行价格 84.00 元/股对应的发行人 2024 年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 23.94 倍，低于招股说明书中所选可比公司 2024 年扣非前后孰低的归母净利润对应静态市盈率的算术平均数 27.78 倍（剔除异常值后，截至 2025 年 6 月 26 日）；对应发行人滚动市盈率（对应的 2024 年 4 月至 2025 年 3 月归母净利润为扣除非经常性损益前后孰低值）为 24.00 倍，低于招股说明书中所选可比公司 2024 年扣非前后孰低的归母净利润对应滚动市盈率的算术平均数 38.51 倍（剔除异常值后，截至 2025 年 6 月 26 日）。

（3）与同行业可比公司主营业务、产品结构、应用领域、客户群体的比较

公司名称	所属行业	主营业务	主要产品、应用领域	相关客户群体
圣泉集团（605589.SH）	化学原料及化学制品制	合成树脂及复合材料、	主要产品：铸造用树脂、酚醛树脂、电子	电子化学品应用于 IC 封

公司名称	所属行业	主营业务	主要产品、应用领域	相关客户群体
	造业 (C26)	生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售	化学品（包括电子级酚醛树脂、特种环氧树脂等）、纤维素、木质素等； 应用领域：铸造材料、新能源储存、食品包装、电子产品、生物质领域等	装、覆铜板生产以及光刻胶，主要客户包括生益科技、建滔集团、南亚新材、华正新材等
东材科技 (601208.SH)	化学原料及化学制品制造业 (C26)	新材料的研发、制造和销售	主要产品：电工绝缘材料、新能源材料、光学膜材料、电子材料（电子级树脂）和环保阻燃材料等； 应用领域：发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G 通信等	电子材料应用于覆铜板生产，主要客户为生益科技等多家知名覆铜板厂商
宏昌电子 (603002.SH)	计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39)	电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售	主要产品：环氧树脂、覆铜板、半固化片等； 应用领域：电子电气、涂料、复合材料等	阻燃环氧树脂应用于覆铜板生产，主要客户包括日本松下、生益科技、汕头超声、联茂电子等

(4) 与同行业可比公司主营业务毛利率的比较

公司与同行业可比公司主营业务毛利率情况比较如下：

公司名称	2024 年度	2023 年度	2022 年度
东材科技	14.12%	19.34%	20.62%
圣泉集团	23.88%	23.16%	20.71%
宏昌电子	5.61%	7.50%	8.69%
平均值	14.54%	16.67%	16.67%
发行人	25.50%	27.91%	24.50%

注：Wind、上市公司披露的定期报告。

与同行业可比公司比较，因产品及应用领域不同，整体上发行人主营业务毛利率高于可比公司。发行人专注于毛利率较高的中高端覆铜板用电子树脂业务。而可比公司业务结构呈现多元化的特点，除经营与发行人具有可比性的电

子树脂业务外，亦涵盖其他领域。

（5）与同行业可比公司研发投入占比的比较

公司与同行业可比上市公司的研发费用占营业收入比率的对比情况如下表所示：

公司简称	研发费用率		
	2024 年度	2023 年度	2022 年度
东材科技	4.30%	5.40%	5.78%
圣泉集团	5.43%	4.74%	4.76%
宏昌电子	2.12%	2.03%	1.90%
行业平均值	3.95%	4.06%	4.15%
发行人	2.27%	2.17%	1.25%

数据来源：wind、上市公司披露的定期报告。

报告期内，研发费用率低于同行业可比上市公司平均值，主要系发行人主营业务突出，产品应用领域和主要客户较为集中，研发成果转化率较高，同时产能紧张不具备大规模中试条件所致。

（6）与同行业可比公司应收账款周转率等财务指标的比较

报告期内，公司应收账款周转率及存货周转率与可比公司的比较如下：

项目	公司名称	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次）	东材科技	5.08	4.99	5.38
	圣泉集团	4.83	5.00	5.97
	宏昌电子	3.68	3.40	3.11
	平均值	4.53	4.47	4.82
	发行人	3.99	3.45	4.06
存货周转率（次）	东材科技	7.84	6.20	7.90
	圣泉集团	4.60	4.87	4.52
	宏昌电子	16.15	15.32	13.50
	平均值	9.53	8.80	8.64
	发行人	9.71	12.47	13.89

数据来源：WIND、上市公司披露的定期报告。

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率处于可比公司中间水平。

3、发行人所处行业基本情况

(1) 电子树脂简介

1) 应用于覆铜板生产的电子树脂分类

对于应用于覆铜板生产的电子树脂，从基团类型和化学结构来说，主要包括环氧树脂、酚醛树脂和苯并噁嗪树脂等；从胶液配方组成来说，可以分为树脂和固化剂，二者交联形成的网状立体结构体现出耐热、耐湿等性能。

PCB 行业的“无铅无卤化”、线路高密度、薄型化、高速高频等发展趋势，对制作覆铜板基体树脂的耐热、尺寸稳定等性能有了更加严格的要求。一直以来，国内外企业着力于电子树脂的升级研究，特种电子树脂应运而生。

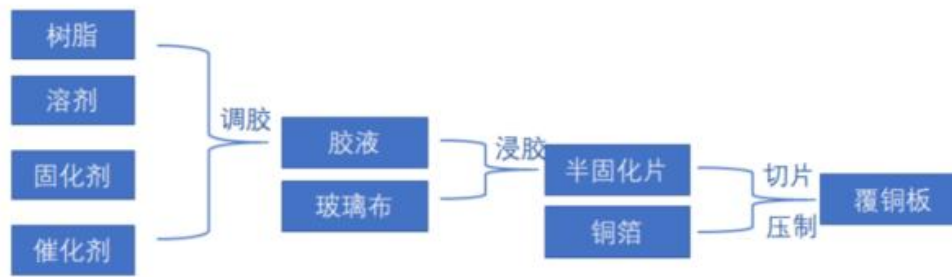
特种电子树脂指的是基于差异化性能需求专门设计的具有特殊的骨架结构和官能团的一系列新型热固性树脂，包括特种骨架结构的环氧树脂、含阻燃特性的酚醛树脂、苯并噁嗪树脂、马来酰亚胺类树脂、聚苯醚树脂等。由特种电子树脂组合制成的覆铜板，其刚性、耐热性、吸水性、线性膨胀系数、尺寸稳定性以及介电性能等指标得以相应改善。

以公司产品 MDI 改性环氧树脂为例，通过用 MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）对基础液态环氧树脂进行改性，在结构中引入特殊的噁唑烷酮杂环结构，有效提升材料与铜箔之间的黏结力，同时固化后玻璃化转变温度明显提高，改善材料耐热性，从而满足高性能覆铜板对基体树脂的使用要求，在计算机、消费电子、汽车等领域得到广泛应用。

2) 电子树脂参与覆铜板生产的具体情况

A、覆铜板主要生产工艺

玻纤布基覆铜板生产工艺流程图



以公司产品应用最多的玻纤布基覆铜板为例，如上图所示，其生产工艺流程包括：调胶、上胶含浸、半固化片切片、排版、上料铜箔热压、裁切和检验等步骤。电子树脂应用于调胶流程，该流程系覆铜板生产的核心工艺环节；由于覆铜板的理化性能、介电性能及环境性能主要由胶液配方决定，因此覆铜板生产厂商通过研制不同的胶液配方，以适配 PCB 生产企业及终端客户的多样化、差异化需求。

B、覆铜板胶液配方体系

覆铜板胶液配方的主要组成包括主体树脂、固化剂、添加剂、填料、有机溶剂等；其中，主体树脂和固化剂是耗用量最大的两个组成部分，胶液配方主要由主体树脂和固化剂搭配发挥作用。具体情况如下：

序号	主要组成	组分名称	主要功能
1	主体树脂	溴化环氧树脂、高溴环氧树脂、MDI 改性环氧树脂、DOPO 改性环氧树脂、双酚 A 型酚醛环氧树脂、非环氧体系的新型树脂（苯并噁嗪树脂等）	提供覆铜板各项物理化学性能，如铜箔剥离强度、玻璃化转变温度、尺寸稳定性、热膨胀系数、低信号损耗、绝缘性能、长期耐环境可靠性等，实现 UL-94V0 阻燃等级（最高阻燃等级）。
2	固化剂	双氰胺、线性酚醛树脂、含磷酚醛树脂固化剂等	大部分主体树脂为热固型树脂，需要在加热和固化剂作用下方能形成立体的交联网状结构，使基体材料具有支撑功能。
3	添加剂	固化促进剂、增韧剂、偶联剂、阻燃助剂等	添加剂具有多种类型，起到促进固化反应、提高阻燃性、增加覆铜板韧性等作用。
4	填料	二氧化硅、氢氧化铝、滑石粉等	填料具有增容（体积）作用，且因其尺寸稳定性，能够降低覆铜板热膨胀系数，改善流动性，辅助阻燃。
5	有机溶剂	丁酮、甲苯等	调节胶液粘度便于生产控制。

C、胶液配方由多种电子树脂组成

胶液配方并非仅包含单一种类电子树脂，而是由多种不同品类、不同特性的电子树脂按一定比例组合而成；由于配方中涉及的化合物繁多，因特性各异，混合后各组分间存在各种交叉反应，各种性能之间既可能相互促进，又可能相互抑制，因此组分的种类及比例的微小调整，均可能影响配方的性能表达。

覆铜板生产厂商需要寻找最佳反应配比，以实现产品的最佳综合表现，同时还需考虑成本和性价比等因素以满足量产需求。

3) 电子树脂配方体系的发展



注：1、除低溴环氧树脂、线性酚醛树脂、以及部分高频高速覆铜板用树脂外，红色方框部分为发行人产品覆盖区域；

2、发行人产品系列丰富，为中高端覆铜板行业提供树脂系统化解决方案。

如上图所示，随着终端应用领域的扩展和基于环保方面的要求，覆铜板类型从普通 FR-4 向高频高速覆铜板演进，电子树脂配方体系亦随之发展。

早期普通 FR-4 覆铜板使用的主要是低溴环氧树脂和传统固化剂双氰胺的搭配，满足基材绝缘、阻燃、支撑的基础功能，具有配方简单、成本低廉的优势。

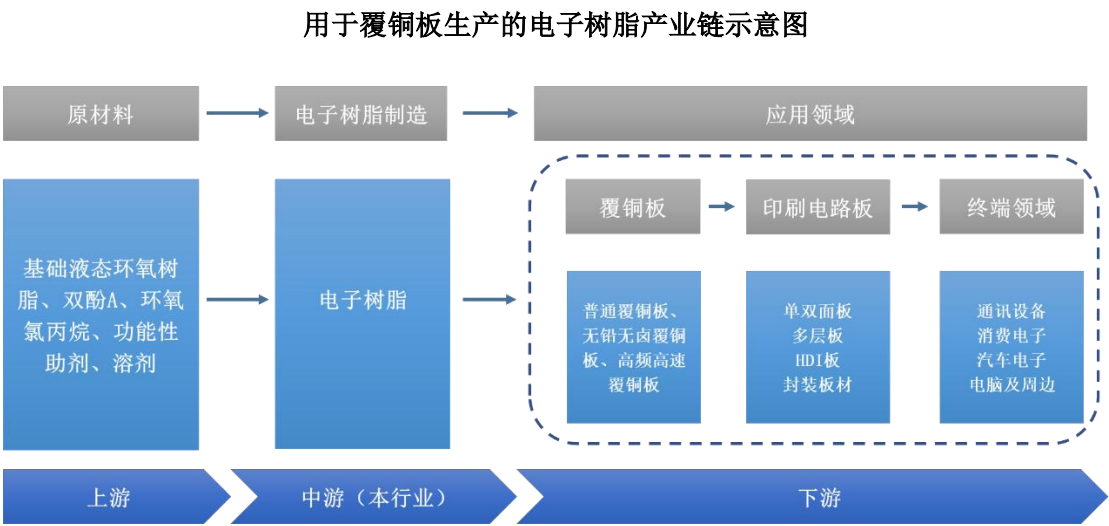
随着环保意识的加强，PCB 行业的“无铅制程”要求覆铜板基材实现较高的耐热性。为提升耐热性，业内普遍以线性酚醛树脂替换双氰胺作为固化剂，但该体系存在脆性较差、铜箔粘结力不足等问题；于是，业内开始使用具有各项特性的多种电子树脂配合的体系解决方案（如上图所示），由于在提升某一

性能同时可能抑制其他性能（如过高的阻燃性将降低耐热性），覆铜板企业需要在各项性能和成本之间实现有效平衡。

后来，电子产品的环保性对 PCB 行业使用无卤素环保材料提出了硬性要求，意味着电子树脂配方需启用新的阻燃剂以替代含卤阻燃剂。在上图所示的配方体系中，不再出现低溴或高溴环氧树脂，而是以 DOPO 这类含磷单体改性而成的环氧树脂或固化剂，搭配其他电子树脂作为无卤覆铜板的解决方案，同时亦能满足 PCB 无铅制程的要求。

随着移动通信技术的发展，PCB 行业对覆铜板的介电性能有着持续提升的要求。由于环氧树脂自身的分子构型和固化后含较多极性基团，对覆铜板的介电性能和信号损耗产生不利影响，因此，基于环氧树脂的覆铜板材料逐渐难以满足高频高速应用需求。经特殊设计，具有规整分子构型和固化后较少极性基团产生的苯并噁嗪树脂、马来酰亚胺树脂、官能化聚苯醚树脂等新型电子树脂应运而生，形成具备优异介电性能和 PCB 加工可靠性的材料体系。

（2）行业上下游关系



1) 上游行业

用于覆铜板生产的电子树脂产业链如上图所示，上游行业为主要原材料，包括双酚 A、四溴双酚 A、环氧氯丙烷、基础液态环氧树脂等，功能性助剂包括 MDI、DOPO 等，溶剂包括丙酮及丁酮等，主要原材料多为大宗商品，价格随市场变动而变化。

2) 下游行业

本行业下游是覆铜板行业，间接应用于印制电路板行业，终端应用领域广泛，包括不限于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备等电子行业。本行业与下游行业关系紧密：从成本占比来说，电子树脂占覆铜板生产成本的比重约为 20-25%，在当前迅速发展的高速高频覆铜板中，电子树脂所占的成本比重将进一步提高，因此，电子树脂是下游行业的重要原材料；从功能作用来说，电子树脂是覆铜板三大组成材料中唯一可设计的有机物，电子树脂的性能特点对覆铜板的性能、品质、加工性等起着关键性作用；从发展趋势来说，终端应用行业的发展方向（如小型化、智能化）衍生出对覆铜板、PCB 性能的需求（如轻薄化、线路高密度化），传导至本行业，带动本行业在技术、工艺和市场方面的快速发展。

(3) 行业发展情况及市场空间

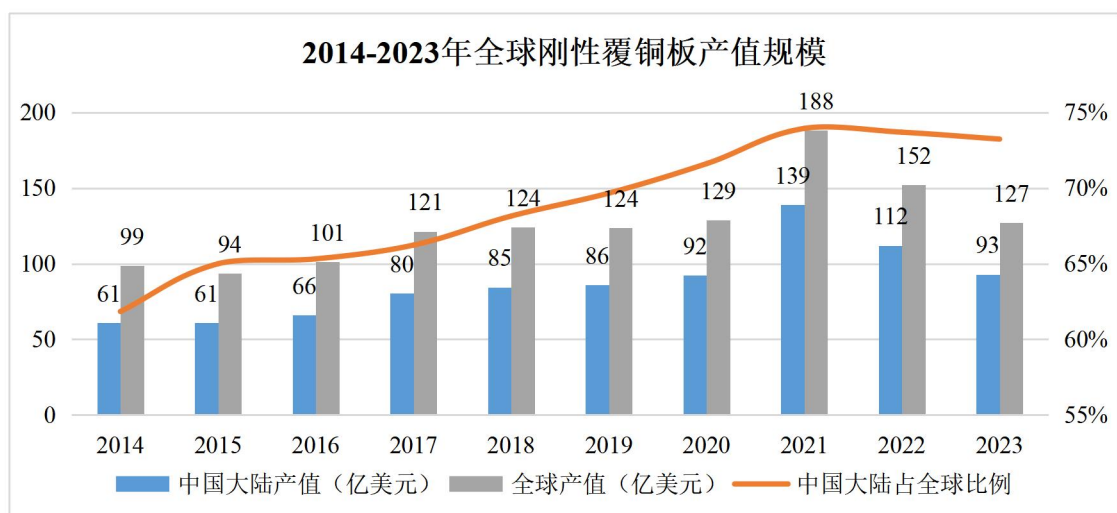
1) 本行业市场规模

根据机械刚性，覆铜板可以分为刚性覆铜板和挠性覆铜板两大类，在刚性覆铜板中，以玻纤布和电子树脂制成的玻纤布基板（FR-4）是目前 PCB 制造中用量最大、应用最广的产品。发行人电子树脂主要应用于玻纤布基板的生产。

根据 Prismark¹ 的统计，全球刚性覆铜板产值从 2014 年的 99 亿美元提升至 2021 年的 188 亿美元，2022 年和 2023 年受宏观经济环境影响，全球刚性覆铜板产值有所下降，为 152 亿美元和 127 亿美元。受益于全球 PCB 产业向我国转移，电子树脂及覆铜板行业亦逐步国产化，我国的覆铜板行业近年来发展迅速，现已成为全球最大的覆铜板生产国。中国大陆刚性覆铜板产值从 2014 年的 61 亿美元增长至 2021 年的 139 亿美元，中国大陆占全球比例进一步提升至 73.9%；2022 年和 2023 年受宏观经济环境影响，中国大陆刚性覆铜板产值有所下降，为 112 亿美元和 93 亿美元。

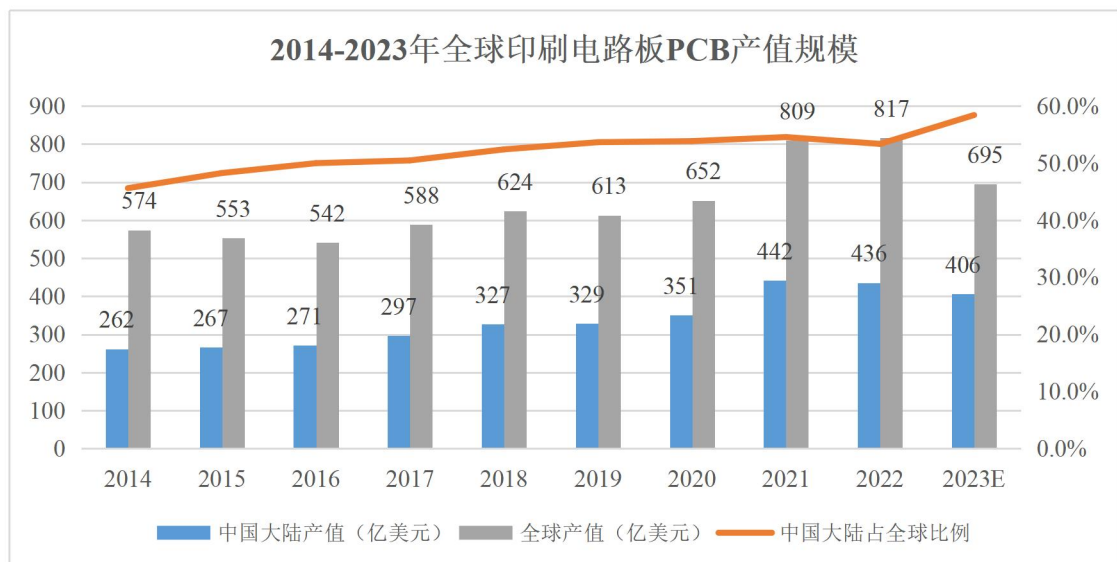
按照成本占比 20% 估算，2022 年用于覆铜板生产的电子树脂的市场规模约为 30.40 亿美元，其中，中国大陆地区的市场规模为 22.40 亿美元。

¹ Prismark 是一家国际知名的电子行业咨询公司，总部位于美国纽约，提供电子行业相关数据、研究及投资机会；发行人未向 Prismark 支付任何费用，引用的数据亦非来自定制报告。



数据来源：Prismark

2) PCB 行业市场规模



数据来源：Prismark

根据 Prismark 的统计，全球 PCB 行业产值从 2014 年的 574 亿美元，提升至 2022 年的 817 亿美元，2023 年受宏观经济环境影响，全球 PCB 行业产值有所下降，为 695 亿美元；我国 PCB 产值规模已达到全球规模 50% 以上。随着 PCB 产业转移的深化，我国 PCB 产值规模比重将进一步提升。

公司生产的电子树脂间接应用于消费电子、通讯设备、汽车电子和计算机等终端市场，因此终端市场对 PCB 的需求间接影响公司的下游市场情况，具体情况如下：

单位：亿美元

应用领域种类	2021 年	2022 年	2023 年 (F)	2026 年 (F)
消费电子	279.74	270.53	219.39	353.00
计算机	190.96	168.51	131.72	194.90
服务器/储存器	78.04	98.94	81.78	124.94
通讯	94.48	102.50	91.50	123.33
汽车	87.28	94.68	91.37	127.72
工业	32.26	33.17	30.30	38.32
医药	15.32	15.53	14.85	17.43
军工/太空	31.13	33.56	34.24	35.96
总计	809.21	817.42	695.15	1,015.60

注：1、消费电子市场包括手机、可穿戴设备、电视、家庭影音/个人设备及其他消费电子；计算机市场包括 PC 以及其他计算机；通讯市场包括有线基础设施及无线基础设施；

2、数据来源：Prismark。

A、消费电子

手机、可穿戴设备等消费电子产品逐渐渗透至各类日常生活中，其在功能性及产品设计上不断创新，为消费电子行业提供了庞大的市场需求。根据 Prismark 数据，2023 年全球消费电子领域的 PCB 产值 219.39 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 31.56%。

B、计算机

计算机市场主要包括平板电脑、笔记本电脑以及大型计算机等，随着计算机升级迭代，其市场需求进一步扩大。根据 Prismark 数据，2023 年全球消费电子领域的 PCB 产值 131.72 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 18.95%。

C、通讯设备

通讯设备市场主要包括基站、路由器和交换机等类别产品，未来期间 5G 通信商用实施将进一步催生通讯电子市场的升级需求。根据 Prismark 数据，2023 年全球通讯电子领域（包含有线/无线基础设施类别）的 PCB 产值 91.50 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 13.16%。

D、汽车电子

汽车行业的智能化与电动化的发展，推动了汽车电子的 PCB 需求上升。一方面，在汽车智能化趋势的发展中，由于各类传感器数量提升以及智能座舱的应用，均驱动了车用 PCB 的需求。另一方面，随着新能源汽车保有量逐渐提升，相较传统燃油汽车，其三电系统（电池、电机、电控）代替了传统燃油车的发动机及相关机械控制系统，为汽车电子的应用提供广大需求基础。根据 Prismark 数据，2023 年全球汽车电子领域的 PCB 产值 91.37 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 13.14%。

E、服务器/储存器

计算机制造行业终端产品种类大致可分为服务器、储存器等。在云计算高速发展，通信技术代际更迭、数据流量急剧增长的背景下，服务器、数据中心等基础设施需求不断扩大，相应 PCB 用量随之增加。根据 Prismark 数据，2023 年全球服务器/储存器的 PCB 产值 81.78 亿美元，占全球 PCB 产业总产值的 11.76%。

3) 覆铜板向中高端领域转型升级，带动高性能电子树脂需求

近年来，随着 5G 通信、智能汽车、数据中心、云计算等技术和需求的快速发展，更环保、更轻薄、线路密度更高的中高端覆铜板已经成为行业发展的主要方向，具体而言：

A、终端电子行业无铅无卤化催生环保型电子树脂需求。

由于制作覆铜板所用的无铅锡膏熔点较高，覆铜板基板需承受更高温度、更大的热冲击和热应力，同时覆铜板基板亦需启用卤素以外的新型阻燃剂，因此能够满足无铅制程和无卤素要求的中高端电子树脂需求日益旺盛。

B、电子产品“轻、小、薄、智”推动电子树脂技术升级。

PCB 导电图形层数增加、线路宽度收窄、密度提高，对压合工艺和蚀刻工艺的精度提出了更高要求，亦推动了电子树脂在热尺寸稳定性、铜箔粘结力等性能方面的技术升级。

C、通讯技术飞速发展提振高性能电子树脂需求。

基于环氧树脂体系的树脂配方难以满足覆铜板生产日益增加的低介电损耗的技术要求，而含磷酚醛树脂固化剂凭借良好介电性能，苯并噁嗪树脂等新型电子树脂凭借规整分子构型以及固化后极性基团产生较少等优势，已成为覆铜板厂商的需求增长点。

（4）行业进入壁垒

1) 技术与工艺壁垒

电子树脂行业属于技术密集型行业，涉及材料、物理、化学、机械、电子、自动控制等多个学科的交叉综合应用，同时随着电子行业新技术、新工艺不断涌现，产品和工艺更新迭代加快，这就要求行业企业必须不断提升技术创新能力、工艺水平及精益生产水平，因此本行业具有较为明显的技术与工艺壁垒。具体情况如下：

A、产品设计壁垒：由于电子树脂对覆铜板性能影响至关重要，因此在进行新产品设计时需要深刻理解终端应用场景与电子树脂特性间的关联，明晰行业发展方向及技术路线。此外，新产品特性一定要匹配覆铜板的工艺特性和操作窗口，比如考虑在覆铜板生产的浸胶环节和压合环节树脂的反应性和流变特性。

B、研发实现壁垒：在硬件方面，要求配置全套合成实验及分析测试设备，对新产品在纯度、分子量等方面的化学特性进行表征分析；还需要拥有覆铜板应用实验及测试设备，以评估新产品在树脂配方体系以及其制成的覆铜板样板中的各项性能。在软件方面，要求必须吸纳多年电子行业从业经验、高分子材料学背景的综合性高端人才。

C、量产实现壁垒：在中试阶段，树脂类别的迭代伴随工艺流程和生产设备的全新设计，试产后反复修改产线设备、优化工艺流程，直到达到品质稳定、目标收率后方能进行批量生产的产线设计。整个量产实现的过程需要较长时间持续优化。

2) 客户认证壁垒

A、客户认证严苛、认证周期较长：作为覆铜板行业的重要基材，电子树脂的配方微调都可能会对覆铜板性能产生重大影响，因此下游客户对电子树脂供应商的认证非常严格，覆铜板客户的认证周期通常需要 3-6 个月，涉及到终端设备商认证的材料通常需要 1-2 年。在通过认证后，客户通常还要通过小批量试产对供应商产品的稳定性与服务能力进行审慎评价，部分客户通过至少 1-2 年小批量验证后才会大批量使用。

B、客户不轻易更换供应商：出于对产品质量稳定性、转换成本等方面的综合考虑，下游客户一般不会轻易更换供应商。

因此客户认证，特别是大客户认证对新进入的企业设置了较高的准入门槛。

3) 资质壁垒

生产方面，覆铜板用环氧树脂、酚醛树脂及苯并噁嗪树脂等树脂产品因自身通常含有溶剂属于危险化学品，根据法律法规要求，相关生产企业必须取得危险化学品登记证、安全生产许可证等诸多资质许可，而取得上述资质的难度较大、时间较长。研发方面，企业需要具备高规格的研发中心、匹配全套覆铜板应用评估测试能力等硬件条件以及配备高素质合成和应用开发人才等软件条件。发行人先后被评为广东省博士工作站、广东省电子级树脂工程技术研究中心，实现上述认证经历了多年时间。因此，电子树脂行业存在较为明显的资质壁垒。

(5) 发行人所处行业的竞争格局及主要竞争对手

1) 电子树脂行业竞争格局

我国作为电子树脂的生产大国和消费大国，在生产领域仍以基础液态环氧树脂为主；制造普通 FR-4 覆铜板的低溴环氧树脂目前由中国台湾企业主导。

在近些年 PCB 行业绿色环保生产的要求下，各方开始聚焦能够满足无铅制程要求和无卤素管控的覆铜板用高性能电子树脂，美、日、韩资和中国台湾企业凭借多年的技术积累、客户厂商供应体系认证、产品性能参数及质量稳定性等方面优势占据了较多的市场份额，随着电子信息行业产业链向我国大陆转移以及内资企业的技术追赶，以发行人为代表的内资企业凭借良好的产品品质、

本土化优势以及精细化服务，已经在各个细分系列成为重要参与者。

在当前增长最为迅速的高速高频以及 IC 载板领域，高性能电子树脂基本由美国、日本企业主导，随着部分内资企业在技术水平方面取得突破，亦开始逐步进入这一领域。

2) 公司的行业竞争地位

公司始终专注于覆铜板生产用电子树脂，打造适用于无铅无卤覆铜板的成熟产品体系，并通过持续的研发投入，向高速高频覆铜板用电子树脂产品方向延伸。

公司当前具备 5 个细分产品品类、多个细分规格产品同时生产的高效率生产能力，为中高端覆铜板行业提供树脂系统化解解决方案。公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系，快速成长为领先的覆铜板领域电子树脂内资供应商。

公司以市场引导研发方向为核心驱动力，在技术上处于内资领先水平，并逐步追赶国际领先企业。公司在无铅无卤覆铜板适用的电子树脂领域，打破了国际领先企业的垄断，有效降低了覆铜板生产企业对外资或台资供应商的依赖，持续提升高性能电子树脂的国产化率；在高频高速覆铜板适用的电子树脂领域，突破了苯并噁嗪树脂、马来酰亚胺树脂、官能化聚苯醚树脂和高阶碳氢树脂等关键核心技术，目前相关产品正处于小批量或中试阶段，上述产品成熟商业化后将填补国内电子树脂在高端应用领域的短板。

3) 主要竞争对手

我国作为电子树脂的生产大国和消费大国，在生产领域仍以基础液态环氧树脂为主。整体来看，高等级覆铜板生产所需的中高端电子树脂产品的供给目前主要由外资及台资公司主导。在高性能覆铜板用电子树脂领域，美、日、韩资和中国台湾企业凭借多年的技术积累、客户厂商供应体系认证、产品性能参数及质量稳定性等方面优势占据了较多的市场份额，随着电子信息行业产业链向我国大陆转移以及内资企业的技术追赶，以发行人为代表的内资企业凭借良好的产品品质、本土化优势以及精细化服务，已经在各个细分系列成为重要参

与者。

目前，发行人主要产品在国内的供应商情况如下表所示：

产品名称	外资、台资供应商	主要内资供应商
MDI 改性环氧树脂	外资：美国欧林公司、韩国科隆 台资：南亚塑料	发行人
DOPO 改性环氧树脂	外资：美国欧林公司、韩国科隆 台资：南亚塑料	发行人、东材科技、宏昌电子
高溴环氧树脂	台资：长春集团、南亚塑料	发行人
BPA 型酚醛环氧树脂	外资：韩国科隆、美国瀚森 台资：长春集团、南亚塑料	发行人、圣泉集团
含磷酚醛树脂固化剂	外资：美国欧林公司、韩国科隆	发行人

综上所述，随着全球 CCL 和 PCB 行业的增长、覆铜板向中高端领域持续转型升级的趋势、以及其于供应链安全考虑的产品进口替代需求，发行人中高端电子树脂产品具有较大市场空间和成长空间。

4、发行人的成长性

（1）突破高性能电子树脂核心技术，具有较强的技术研发能力

1) 发行人产品与外资、台资产品处于同一技术水平

覆铜板的理化特性和介电性质等性能指标主要受到电子树脂胶液配方的影响，覆铜板生产厂商根据具体应用场景和下游客户的要求，选择具有相应特性的电子树脂，调整其用量比例以形成适配的胶液配方。

随着 PCB 行业的技术发展，其对中高端覆铜板有着较高的性能和质量要求，因此覆铜板生产厂商对于产品的性能指标和工艺管控非常严格，就其所需的电子树脂原材料而言，要求电子树脂产品品质保持稳定，测量产品稳定性的性能指标主要有环氧当量、固含量、溴含量、磷含量等，要求产品的环氧当量、固含量、溴含量、磷含量等指标保持在一定的范围内，不能出现较大的波动。性能指标和大批量生产下的稳定性指标是覆铜板厂商选择供应商的重要考量因素。一般只有具有较强综合实力及较强生产技术管理能力的电子树脂生产厂商才能掌握符合标准的生产工艺、保持较好的生产一致性并实现批量化生产。

我国中高端电子树脂市场长期为外资及台资供应商主导，发行人通过不断

研发积累，突破关键工艺节点，部分电子树脂产品已成功替代了外资、台资产品，相关产品指标与长期主导市场的外资及台资供应商的产品处于同一技术水平，部分产品的指标对比情况如下：

A、MDI 改性环氧树脂

公司名称	产品型号	环氧当量 (g/eq)	固含量 (%)
美国欧林	X***03	280-305	74-76
韩国科隆	K***75	285-315	未披露
发行人	T***75	280-330	74-76

注：1、环氧当量是指每摩尔环氧基对应的产品中不挥发物质的克数；
2、固含量是指每单位产品中不挥发物质的质量百分比；

B、高溴环氧树脂

公司名称	产品型号	环氧当量 (g/eq)	固含量 (%)	溴含量 (%)
南亚塑料	N***60	380-420	59-61	46-50
长春集团	B***00	380-420	固体	46-50
发行人	TE***60	380-420	59-61	46-50

注：溴含量是指每单位产品中溴元素与不挥发物质的质量百分比。

C、BPA 型酚醛环氧树脂

公司名称	产品型号	环氧当量 (g/eq)	固含量 (%)	可水解氯 (ppm)	加德纳色度 (Ganrder)
韩国科隆	K***70	190-235	69-71	0-500	≤6
美国瀚森	E***8	195-230	固体	未披露	≤6
长春集团	B***00	190-210	固体	未披露	未披露
南亚塑料	N***80	185-210	79-81	未披露	≤5
发行人	TE***A80	185-225	79-81	0-300	≤5

注：1、可水解氯是指每单位产品中可水解的氯元素占不挥发物质的质量百分比。
2、加德纳色度是量测黄色深浅的度量。

D、含磷酚醛树脂固化剂

公司名称	产品型号	磷含量 (%)	固含量 (%)
美国欧林	X***41	未披露	54-58
韩国科隆	K***60	未披露	59-61

发行人	T***60	8.5-9.5	59-61
-----	--------	---------	-------

注：磷含量是指每单位产品中磷元素与不挥发物质的质量百分比。

发行人产品均满足下游覆铜板生产企业对于电子树脂性能参数和稳定性的要求，发行人产品与外资、台资产品已处于同一技术水平。发行人的主要产品与同行业外资台资企业的产品在产品性能参数方面无明显差异，应用在覆铜板生产上技术性能指标相当，实现了进口替代。

2) 掌握多项核心技术，实现商业化应用

公司是少数掌握多系列无铅无卤及高速覆铜板用电子树脂核心技术的内资企业，通过自主研发，公司掌握突破了含磷阻燃改性环氧合成技术、异氰酸酯改性环氧合成技术等多项关键核心技术并均完成产品转化，实现了商业化应用。公司的无卤高 CTI 环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂、苯并噁嗪树脂被认定为广东省高新技术产品。

3) 依托创新平台和资深团队，不断驱动技术创新

公司是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、广东省博士工作站、广东省电子级树脂工程技术研究中心，具备完善的科研硬件条件。公司核心团队成员深耕覆铜板产业链近二十年，是行业内资深人士，曾带领公司荣获第七届中国创新创业大赛新材料行业成长组全国第七名。

相较外资、台资竞争对手，公司管理团队均具有深厚技术背景，研发架构更为扁平，一方面有利于灵活高效地及时响应客户需求，另一方面，有利于将研发产品技术路线与公司战略方向深度绑定，有助于提高研发效率和研发成果转化率。

4) 自主设计优化产线，攻克关键工艺难关，结合 DCS 集中控制系统，保证品质稳定、降低生产成本的同时具备快速交付能力

A、成功攻克关键工艺难关：公司攻克了 DOPO 衍生物改性环氧树脂生产过程中的杂质控制、苯并噁嗪树脂低游离酚控制、含磷酚醛低游离单体控制等一系列工艺难关，通过优化相应产线设备和生产流程，公司实现了产线与工艺的高度匹配。

B、较高的生产管理水平：公司采用 DCS 自动化控制系统，实现生产过程的集中监测、安全连锁及自动化操作，可精准控制生产过程中每个环节，确保生产的安全、稳定、高效运行，具备较高的生产管理水平。

C、连续自动化的量产能力：公司自成立以来不断升级、改造和扩展产线，目前已具备年产 3.7 万吨电子树脂的生产能力；公司产线具备连续化、批量化、自动化的生产特点，相对于在单反应釜中完成所有反应过程，公司产线能够实现精确控制、多反应釜分步反应、连续生产的高效生产过程，提高了 3-5 倍的生产效率，可快速稳定交付；产线灵活，还具备多品种、小批量的定制化优势。

经发行人改进优化后的连续自动化生产线提高了公司主要产品的产率、收率，保障了产品的品质一致稳定，降低了杂质或废聚物产生，保证了产品纯度，使得公司主营产品从技术指标到生产成本均具有较强竞争力。

（2）高性能电子树脂存在较大的国产化空间，发行人凭借技术创新，在中高端电子树脂领域打破了外资、台资企业的技术垄断

用于覆铜板生产的电子树脂行业萌芽于上世纪的西方世界，德国、美国等化学家奠定了覆铜板主要材料的研究和发展基础，上世纪四十年代，电子树脂在覆铜板生产领域实现工业化。基于长达半世纪的技术积累和市场优势，覆铜板电子树脂行业，尤其应用于高性能覆铜板的电子树脂，至今仍由美国、韩国、日本及中国台湾的企业主导。

随着全球电子信息制造业向亚洲特别是中国大陆地区转移，外资及台资覆铜板厂商纷纷在大陆投资建厂，大陆内资厂商亦开始崭露头角，产业链的转移及全球电子行业的高景气推动了电子树脂行业国产化的进程。

我国电子树脂生产企业起步较晚，产品性能参数、质量和稳定性与经营多年的国际企业存在一定差距。目前在供给结构上，我国电子树脂产能以基础液态环氧树脂居多，高品质的特种电子树脂较少；尤其，能够满足下游 PCB 行业在绿色环保（无铅无卤）、轻薄化、高速高频等方面要求的特种电子树脂供应紧张，高度依赖进口。在我国战略性布局电子信息产业及新材料产业的大背景下，电子树脂行业的市场结构亟待进一步优化，应用于中高端覆铜板生产的高

性能电子树脂存在较大的国产化空间，我国本土的电子树脂生产企业蕴含巨大的市场空间和发展潜力。

1) 实现进口替代的产品、替代时间

发行人凭借技术创新，在中高端电子树脂领域打破了外资、台资企业的技术垄断，有效降低了覆铜板厂商对进口电子树脂的依赖，实现了进口替代，具体产品及实现进口替代的时间情况如下：

发行人产品名称	实现进口替代的时间
MDI 改性环氧树脂	2016 年
DOPO 改性环氧树脂	2016 年
高溴环氧树脂	2016 年
含磷酚醛树脂固化剂	2017 年
BPA 型酚醛环氧树脂	2021 年
苯并噁嗪树脂	2021 年
马来酰亚胺树脂	2021 年

上述产品中，MDI 改性环氧树脂、DOPO 改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA 型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂为公司主要产品；报告期内，公司已完成了对苯并噁嗪树脂、马来酰亚胺树脂等特种树脂的小批量生产并实现销售，但因受限于公司自身产能，产量较小，未成为公司主要产品。

2) 替代程度

A、发行人主要产品占主要客户同类产品采购份额整体呈上升趋势

近年来，出于对供应链安全等因素的考虑，发行人主要客户逐渐加大对国内供应商的采购，发行人销售数量和所占份额稳步增长，尤其是建滔集团和生益科技的增长速度较快。根据主要客户提供的关于相关采购份额信息的协作函，发行人部分产品占南亚新材、建滔集团、华正新材、金宝电子相关产品的采购份额已达到 50%以上，发行人相关产品占主要客户同类产品的采购份额整体呈上升趋势，发行人主要产品的进口替代程度逐渐提升。

B、发行人相关产品销售数量逐渐增长

报告期内，发行人部分产品的销量变化情况如下：

单位：吨

项目	2024 年	2023 年	2022 年
MDI 改性环氧树脂	19,414.76	18,530.54	18,564.60
高溴环氧树脂	4,645.50	5,633.14	4,783.40
DOPO 改性环氧树脂	4,317.32	3,521.06	3,011.68
含磷酚醛树脂固化剂	3,709.74	2,756.59	2,295.21
BPA 型酚醛环氧树脂	10,599.67	7,234.61	7,405.05

由上可见，随着发行人产能的稳定提升，相关产品销量亦大幅增长，进口替代程度逐渐提高。

3) 替代前后相关领域的竞争情况

我国作为电子树脂的生产大国和消费大国，在生产领域仍以基础液态环氧树脂为主。在近年来 PCB 行业绿色环保生产的要求下，各方开始聚焦能够满足无铅制程要求和无卤素管控的覆铜板用高性能电子树脂。美、日、韩资和中国台湾企业凭借多年的技术积累、客户厂商供应体系认证、产品性能参数及质量稳定性等方面优势占据了较多的市场份额；随着 PCB 产业链向我国大陆转移以及内资企业的技术追赶，以发行人为代表的内资企业凭借良好的产品品质、本土化优势以及精细化服务，已经在各个细分产品系列成为重要参与者。

发行人相关产品实现进口替代前后，在国内市场的竞争情况如下表所示：

产品名称	替代前主要供应商	替代后主要供应商
MDI 改性环氧树脂	外资：美国欧林公司、韩国科隆 台资：南亚塑料	外资：美国欧林公司、韩国科隆 台资：南亚塑料 内资：发行人
DOPO 改性环氧树脂	外资：美国欧林公司、韩国科隆 台资：南亚塑料 内资：东材科技、宏昌电子	外资：美国欧林公司、韩国科隆 台资：南亚塑料 内资：发行人、东材科技、宏昌电子
高溴环氧树脂	台资：长春集团、南亚塑料	台资：长春集团、南亚塑料 内资：发行人
BPA 型酚醛环氧树脂	外资：韩国科隆、美国瀚森 台资：长春集团、南亚塑料 内资：圣泉集团	外资：韩国科隆、美国瀚森 台资：长春集团、南亚塑料 内资：发行人、圣泉集团
含磷酚醛树脂固化剂	外资：美国欧林公司、韩国科隆	外资：美国欧林公司、韩国科隆 内资：发行人
苯并噁嗪树脂	外资：美国亨斯迈、日本日立	外资：美国亨斯迈、日本日立

产品名称	替代前主要供应商	替代后主要供应商
	(注 1) 内资：成都科宜 (注 2)	内资：发行人、成都科宜
马来酰亚胺树脂	外资：日本大和化成 (注 3)、 日本 KI 化成 (注 4) 内资：东材科技	外资：日本大和化成、日本 KI 化成 内资：发行人、东材科技

注 1：指“日立化成株式会社”，Hitachi Chemical Company, Ltd.;

注 2：指“成都科宜高分子科技有限公司”;

注 3：指“大和化成株式会社”，Daiwa Fine Chemicals Co., Ltd.;

注 4：指“ケイ・アイ化成株式会社”，K・I Chemical Industry Co., Ltd.。

由上可见，发行人打破了外资、台资企业对 MDI 改性环氧树脂、高溴环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等电子树脂产品的垄断，成为了下游客户相关产品的重要供应商，降低了我国覆铜板厂商对进口电子树脂产品的依赖。

A、MDI 改性环氧树脂

在发行人推出 MDI 改性环氧树脂产品之前，该产品在国内市场主要由美国欧林公司、韩国科隆、南亚塑料等外资和台资企业垄断。发行人在 2015 年成立之初，便确定以 MDI 改性环氧树脂和 DOPO 改性环氧树脂作为市场切入点，公司在通用合成技术的基础上不断试验不同种类环氧树脂与 MDI、DOPO 及其衍生物、阻燃剂、催化剂的配比，并反复优化工艺流程节点，成功摸索出 MDI 改性环氧树脂和 DOPO 改性环氧树脂系列产品，能够满足无铅无卤覆铜板对耐热性、阻燃性等性能的要求，达到进口替代的技术水平。

当 2016 年 4 月 MDI 改性环氧树脂面市时，正值覆铜板客户转型升级的初期以及供应链国产化趋势发展时期，该产品得以短期内顺利通过南亚新材、建滔集团和诺德集团的认证，正式与外资及台资产品展开竞争；自 2016 年至 2018 年，该产品在业内打开局面，集中获得了超声电子、生益科技、金宝电子、华正新材等客户认证，加速了国产化替代进程；自 2019 年至今，发行人通过技改持续扩大产能，加强产品供应，逐年提高国产化替代率。

B、DOPO 改性环氧树脂

与 MDI 改性环氧树脂相同，DOPO 改性环氧树脂也是发行人成立初期即推出的产品，发行人对该产品的技术积累较为深厚，已经形成多规格产品体系，能够满足不同无卤覆铜板胶液配方的要求。该产品因各生产企业技术路径不同，

产品指标性能有所差异，部分客户习惯沿用原胶液配方即使用进口产品；公司通过提供系统化解决方案，优化配方配比，布局转型升级潜力客户，改进产线、扩充产能，陆续通过了南亚新材等主要客户的认证，实现国产化率稳步提升。

C、高溴环氧树脂

高溴环氧树脂是无铅覆铜板胶液配方的组成部分，相关市场长期以来由长春集团、南亚塑料等台资企业主导。自 2016 年至 2019 年，发行人在车间二研发、试产高溴环氧树脂并陆续通过南亚新材、生益科技和新华电子等客户认证，开始批量供应，打破了台资厂商的市场垄断，实现了一定程度的国产替代。2020 年 9 月，发行人完成车间一技改，新建连续自动化生产线以扩大产能，同时延伸了生产流程实现了关键原材料固态高溴环氧树脂自产、可控；该产品得以取得江西航宇、诺德集团、超声电子、金宝电子和华正新材等客户测试认证，有效提升了进口替代份额。

D、BPA 型酚醛环氧树脂

BPA 型酚醛环氧树脂的生产工艺复杂、技术要求严格，相关市场常年由韩国科隆、美国瀚森、长春集团、南亚塑料等外资、台资企业把控，在 2021 年初公司正式推出该产品前，国产化方面仅有圣泉集团等极少数内资企业拥有批量供应能力。2019 年 1 月，基于对市场的研判，发行人首次研发立项，积累了一定的技术和生产经验；2020 年 6 月，为满足下游客户迫切需求，发行人再次立项进行研发试制，待 2021 年初，公司经过技改、配备了一条连续自动化产线，顺利通过南亚新材、建滔集团等知名客户的认证，开始大批量供应，成为了该产品在国内市场的主要内资供应商之一，较大程度上加速了该产品国产化替代进程。

E、含磷酚醛树脂固化剂

含磷酚醛树脂固化剂作为无卤阻燃固化剂，可应用于无卤覆铜板和高速覆铜板，制程长、技术门槛较高，大部分内资企业长期处于技术追赶的阶段，相关市场主要由美国欧林公司、韩国科隆等外资厂商所主导。自 2016 年末至 2020 年，发行人该产品陆续取得主要客户认证，实现了一定程度的进口替代；

2020年9月，车间一技改完成，发行人通过自主设计建设了连续自动化产线，延伸了该产品的生产流程，实现了醚化酚醛树脂原材料自产，在扩大产能的同时保障了产品的一致稳定性，打破了外资企业对这一细分市场的垄断，成为了该类产品的内资供应商，且国产化替代率持续提高。

F、苯并噁嗪树脂

苯并噁嗪树脂具有良好的耐热性、耐湿性、良好的力学性能和电气性能，在无铅工艺和HDI板的应用中具有较为突出的优势。相关市场长期由美国亨斯迈、日本日立等外资企业把控，在发行人推出该产品前，国内市场的内资供应商仅有成都科宜等少数企业。发行人自2017年初开始开展苯并噁嗪树脂的开发研究工作，通过分子设计、工艺开发等工作，开发匹配覆铜板行业要求的不同结构的苯并噁嗪树脂，积累了相关技术和经验。至2021年下半年，通过开展产业化研究、解决生产过程难点，实现了具有高耐热和低介电等性能的多种型号的苯并噁嗪树脂的产业化生产，具备了一定的小批量生产和市场供应能力。

G、马来酰亚胺树脂

马来酰亚胺树脂具有较高的耐热性和较低的介电损耗，是5G用低损耗覆铜板、半导体封装等的重要原材料。由于马来酰亚胺树脂生产工艺复杂，副产物处理困难，品质稳定性要求高，相关细分市场长期由日本大和化成、KI化成等外资企业主导，内资厂商方面仅有东材科技等少数企业拥有批量供应能力。发行人自2019年初开始开展马来酰亚胺系列树脂的研究开发工作，通过研究合成路线、工艺路线、分离纯化工艺以及加工设备匹配等工作，现已经具备了多个型号的马来酰亚胺树脂的小批量生产和市场供应能力，并取得了南亚新材等客户的测试认证，成为了该产品在国内市场的内资供应商之一。新厂江西同宇投产后，公司将进一步扩大该系列产品的产能产量，提高交付能力，加快其国产化替代进程。

4) 进口替代产品主要客户的合作稳定性

A、发行人与主要客户的合作历史较长，合作情况稳定

公司于2016年与南亚新材、建滔集团、生益科技、华正新材和超声电子建

立了业务合作，于 2017 年与金宝电子建立了业务合作，公司与主要客户均有较长的合作历史，合作关系持续稳定。

B、客户认证严苛、认证周期较长，不会轻易更换供应商

作为覆铜板行业的重要基材，电子树脂的配方微调都可能会对覆铜板性能产生重大影响，因此下游客户对电子树脂供应商的认证非常严格，覆铜板客户的认证周期通常需要 3-6 个月，涉及到终端设备商认证的材料通常需要 1-2 年。在通过认证后，客户通常还要通过小批量试产对供应商产品的稳定性与服务能力进行审慎评价，部分客户通过至少 1-2 年小批量验证后才会大批量使用。此外，出于对产品质量稳定性、转换成本等方面的综合考虑，下游客户一般不会轻易更换供应商。

C、通过优异的品质及服务获取客户认可

公司采取直销的销售模式，与下游覆铜板企业客户直接对接，充分贴近 PCB 电子产业市场需求。公司本土化便捷的产品交付，不仅有利于降低客户库存成本，而且能做到快速的服务响应，提供公司产品应用到客户产品的解决方案。此外，公司建立了全面的客户回馈机制，每半年定期进行正式的客户满意度调查，而公司人员至少每月与客户相关人员进行交流，能够第一时间掌握客户针对产品技术、商务条件方面的问题，并及时解决。这有效的保证了客户满意度，增加了客户黏性。

同时，公司建立了《产品交付管理程序》《产品检验管理程序》等管理制度，保障了产品交付的及时性和产品质量的稳定性，取得了客户的信任和认可。长期以来，客户对公司的快速响应能力、服务态度、供货能力及产品质量均较为满意，未来会持续与公司进行合作。

综上所述，2022 年发行人对各主要客户的销售收入整体增长，2023 年和 2024 年度对主要客户的销售数量同比仍保持增长，但受原材料价格下降影响，销售收入有所波动；公司与主要客户均有较长的合作历史，客户认证严苛、认证周期较长；公司高度重视对下游客户的整体服务，客户对公司的满意度较高；发行人与进口替代产品的主要客户的合作持续、稳定。

(3) 公司产品销量持续增长，下游市场需求旺盛，募投达产后公司电子树脂产品的生产能力将大幅提升

报告期内，发行人母公司产能利用率分别为 100.04%、105.93%和 116.37%。发行人母公司产能利用率已经饱和，现有的生产能力已经难以充分满足下游市场需求。报告期内，公司产能利用率情况如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
产能（吨）	37,000.00	37,000.00	37,000.00
产量（吨）	43,058.47	39,195.93	37,013.15
产能利用率	116.37%	105.93%	100.04%
销量（吨）	43,347.35	38,887.73	36,875.80
产销率	100.67%	99.21%	99.63%

注：新厂江西同宇于 2024 年 7 月开始投产，处于设备调试、试生产、产能爬坡阶段，产能尚未稳定；以上为母公司数据。

报告期内，公司主要产品销量变动情况如下：

单位：吨

产品类别名称	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	销量	增长率	销量	增长率	销量	增长率
MDI 改性环氧树脂	19,414.76	4.77%	18,530.54	-0.18%	18,564.60	64.24%
高溴环氧树脂	4,645.50	-17.53%	5,633.14	17.76%	4,783.40	21.53%
DOPO 改性环氧树脂	4,317.32	22.61%	3,521.06	16.91%	3,011.68	-12.15%
BPA 型酚醛环氧树脂	10,599.67	46.51%	7,234.61	-2.30%	7,405.05	101.11%
含磷酚醛树脂固化剂	3,709.74	34.58%	2,756.59	20.10%	2,295.21	15.50%
其他	2,877.48	139.45%	1,201.69	57.04%	765.24	-12.69%
合计	45,564.48	17.20%	38,877.62	5.57%	36,825.18	46.06%

报告期各期，公司主要产品销量分别为 36,825.18 吨、38,877.62 吨和 45,564.48 吨，截至 2022 年末，发行人产能已基本饱和，2023 年受产能制约，产品销售数量增长有限，同比增长 5.57%。2024 年，为满足下游客户需求，发行人母公司通过优化生产效率提高了产能利用率，且新厂江西同宇 2024 年 7 月开始投产，产能逐步释放，综合影响导致公司主要产品销量同比增长 17.20%。

公司本次拟实施的募集资金投资项目中，“新厂江西同宇新材料有限公司

年产 20 万吨电子树脂项目（一期）”以现有主营业务和核心技术为基础，新建生产场地，实现年产 15.2 万吨电子树脂。一方面，本项目对现有成熟拳头产品进行扩产，可以有效解决公司现有场地不足、产能瓶颈问题，进一步加强对下游客户的供应和服务能力，巩固公司的行业地位；另一方面，符合公司未来发展规划，在适用于通讯领域的高速高频覆铜板电子树脂方面实现量产，促进公司可持续发展。本次募集资金投资项目全部建成投产后，公司电子树脂产品的生产能力将大幅提升。

6、发行人的竞争优势

（1）产品体系优势

公司通过不断的研发投入，以及对下游覆铜板制造企业的紧密合作，已构建了成熟多样的产品规格体系。公司产品规格覆盖了从适用于高中低玻璃化转变温度无铅无卤覆铜板，到低 Dk 低 Df 高速领域覆铜板的产品，公司的电子树脂可以紧跟电子行业的发展，为下游覆铜板制造企业丰富的产品规格体系，为公司的业务发展奠定了良好的市场基础。

（2）客户认证优势

覆铜板行业产品认证是重要的市场准入门槛，公司生产的电子树脂在满足权威机构认证的标准之外，亦需要满足下游及终端设备生产商户在材料各方面性能的全面的认证，通常认证内容更为详细、严格，认证周期更长。公司凭借提供电子树脂的系统化解决方案、高标准的产品、专业的配套服务，赢得了众多下游覆铜板生产知名企业的信赖。经过多年的研发与探索，公司已取得建滔集团、生益科技、南亚新材、超声电子、华正新材等知名厂商认证，进入其供应商体系，建立了长期稳定的合作关系。

（3）技术研发优势

公司专注于电子树脂的研发、生产和销售，经多年积累，尤其在产品的应用及生产领域积累了大量技术和实践经验。此外，公司在研发领域的核心管理团队在行业内从业经验丰富，对市场发展方向进行了前瞻性的技术储备。公司是少数掌握多系列无铅无卤及高速电子树脂核心技术的内资企业，并积极

推进高端应用领域电子树脂的国产化率，具备较强的技术研发能力。公司陆续攻克 DOPO 衍生物改性环氧树脂生产过程中的杂质控制、苯并噁嗪树脂低游离酚控制、含磷酚醛低游离单体控制、聚苯醚氧化反应分子量与官能度控制等一系列技术难关，拥有 16 项授权发明专利，优秀的技术研发优势为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。

（4）贴近市场优势

公司采取直销的销售模式，与下游覆铜板企业客户直接对接，充分贴近 PCB 电子产业市场需求。本土化便捷的产品交付，有利于降低客户库存成本、平衡市场需求以及价格波动风险；快速的品质投诉响应，有利于及时解决问题、降低客户流水线作业的品质异常成本；定期面对面开展研发部门之间的技术交流，有利于快速推进项目进度、缩短项目开发周期；与终端厂商密切接触，有利于及时准确了解行业发展趋势。

（5）制造技术优势

公司拥有 DCS 自动控制生产线，凭借公司生产与技术团队多年的技术积累，积极改造生产线设备，优化生产工艺流程，在成熟产品方面持续提升交付效率，已经具备差异化较大的 5 个系列产品以及多个规格单品同时生产快速交付的制造能力；生产线自动化程度高，保证产品质量稳定；拥有全套的小型以及中批量试验反应装置，在新产品方面拥有快速的中小批量量产能力，较快的配合项目初期认证，缩短产品认证周期。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量和发行结构

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行新股数量为 1,000.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，本次发行均为新

股，全部为网上发行，原股东不公开发售股份。本次公开发行后总股本为4,000.00 万股。

（三）发行价格

发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 84.00 元/股。

（四）募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 130,000.00 万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除预计发行费用 7,962.17 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 76,037.83 万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

（五）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2 日 2025 年 6 月 27 日 (周五)	披露《招股说明书》《网上路演公告》《创业板上市提示公告》等相关公告与文件
T-1 日 2025 年 6 月 30 日 (周一)	披露《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2025 年 7 月 1 日 (周二)	网上发行申购日（9:15-11:30、13:00-15:00） 网上申购配号
T+1 日 2025 年 7 月 2 日 (周三)	披露《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签
T+2 日 2025 年 7 月 3 日 (周四)	披露《网上摇号中签结果公告》 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 2025 年 7 月 4 日 (周五)	保荐人（主承销商）根据认购资金到账情况确定包销金额
T+4 日 2025 年 7 月 7 日 (周一)	披露《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

注：1、T 日为网上发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

（七）限售期安排

本次发行的股票无流通限制及限售期安排。

三、网上发行

（一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为 2025 年 7 月 1 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上申购价格

本次发行的发行价格为 84.00 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“同宇新材”，申购代码为“301630”。

（四）网上投资者申购资格

2025 年 7 月 1 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限，且在 2025 年 6 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。

发行人和保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为 1,000.00 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2025 年 7 月 1 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00）将 1,000.00 万股“同宇新材”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）申购规则

1、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 10,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

投资者持有的市值按其 2025 年 6 月 27 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2025 年 7 月 1 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

2、网上投资者申购日 2025 年 7 月 1 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2025 年 7 月 3 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。对于申购量超过网上申购上限 10,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。同一投资者使用多个证券账户参与同一只

新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（七）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开通创业板市场交易权限。

2、计算市值和可申购额度

投资者持有的市值按其 2025 年 6 月 27 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2025 年 7 月 1 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

3、开立资金账户

本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2025 年 7 月 1 日（T 日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2025 年 7 月 1 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1) 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

(2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3) 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

(4) 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。

(5) 投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

(八) 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 500 股。

中签率=（网上发行数量÷网上有效申购总量）×100%。

(九) 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2025 年 7 月 1 日（T 日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网

点。

2025 年 7 月 2 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐人（主承销商）将于 2025 年 7 月 2 日（T+1 日）在刊登的《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2025 年 7 月 2 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）将于 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）在刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

投资者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2025 年 7 月 3 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

（十一）放弃认购股票的处理方式

2025年7月3日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2025年7月4日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2025年7月4日（T+3日）16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效处理。投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。

（十二）投资者缴款认购的股份数量不足情形

当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，本次发行因网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%，即300.00万股。

发行人和保荐人（主承销商）将在2025年7月7日（T+4日）公告《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐人（主承销商）的包销比例。

四、中止发行

1、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：

- （1）网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的；
- （2）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；

(3) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(4) 根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条的规定,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

2、中止发行的措施

2025年7月4日(T+3日)16:00后,发行人和保荐人(主承销商)统计网上认购结果,确定是否中止发行。如中止发行,发行人和保荐人(主承销商)将尽快公告中止发行安排。中止发行后,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会予以注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

五、余股包销

网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行。

网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2025年7月7日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金与网上发行募集资金扣除未收取的保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

六、发行费用

本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

七、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人：同宇新材料（广东）股份有限公司

法定代表人：张驰

联系地址：广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区（西南一区编号 ES1020）

联系人：郑业梅

联系电话：0758-3202908

（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：苏军良

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 19 楼

联系人：销售交易业务总部

联系电话：021-20370807，021-20370809

发行人：同宇新材料（广东）股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

(本页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)

发行人：同宇新材料（广东）股份有限公司



2025年6月30日

（本页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司



2025 年 6 月 30 日